

Xinger®

Micro Xinger 3dB Hybrid Coupler



Description

The 1M803 Micro Xinger® is a low profile, miniature 3dB hybrid coupler in an easy to use surface mount package designed for U-NII, ISM and hyper LAN applications. The 1M803 is designed for balanced amplifiers and signal distribution and is an ideal solution for the ever increasing demands of the wireless industry for smaller printed circuit boards and high performance. Parts have been subjected to rigorous qualification testing and units are 100% tested. They are manufactured using materials with x and y thermal expansion coefficients compatible with common substrates such as FR4 and G-10. Available in both 5 of 6 tin lead (1M803) and 6 of 6 RoHS compliant tin immersion (1M803S).

Features:

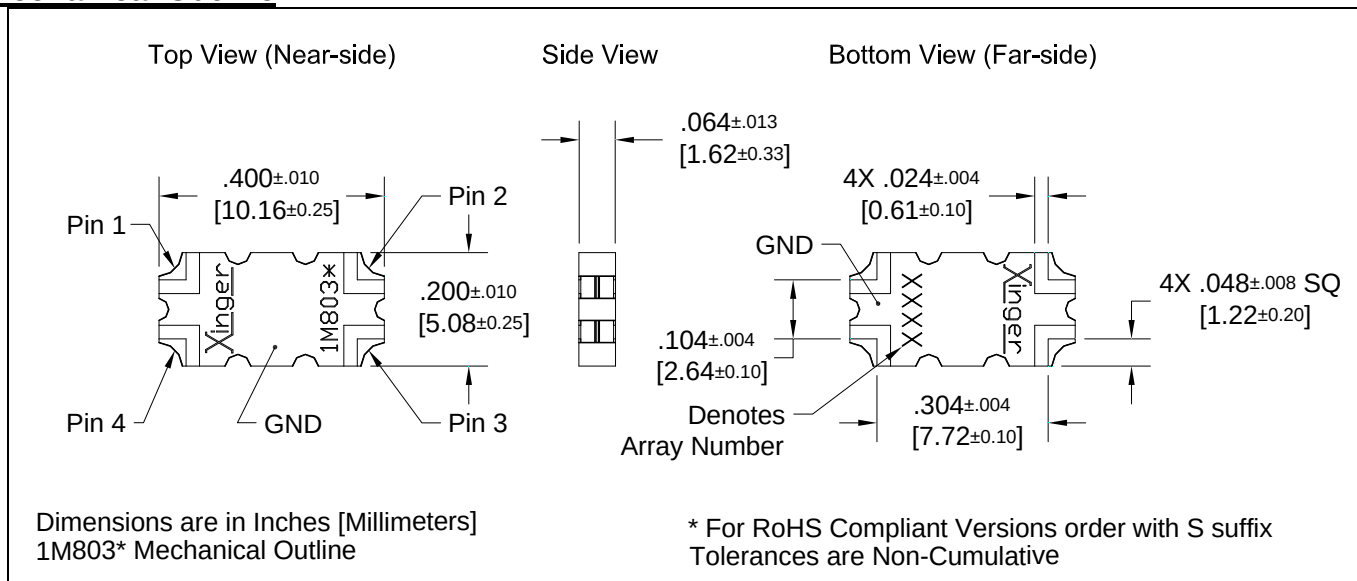
- Very Low Loss
- High Isolation
- 90° Quadrature
- Surface Mountable
- Tape And Reel
- Available in Lead-Free (as illustrated) or Tin-Lead

ELECTRICAL SPECIFICATIONS**

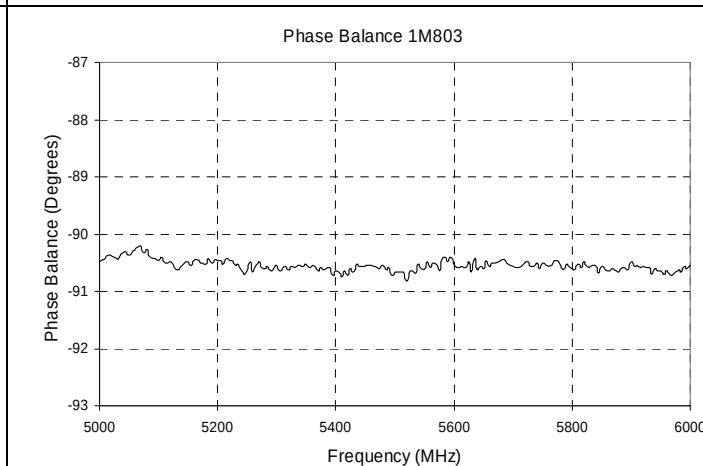
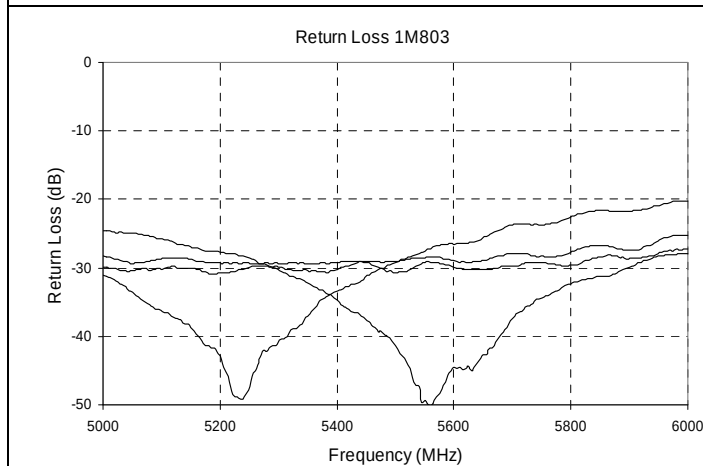
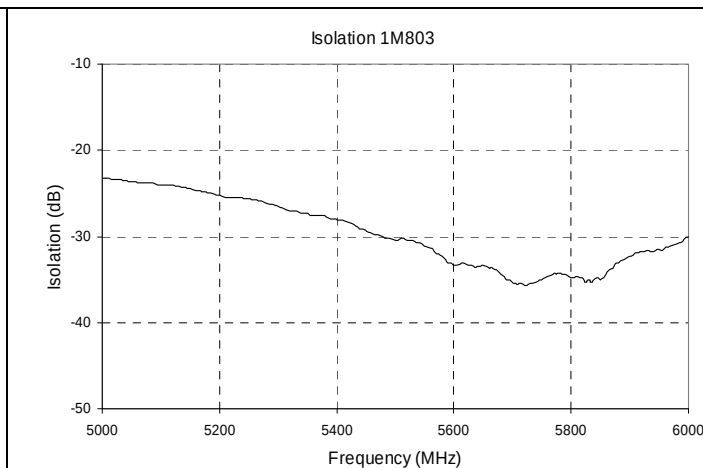
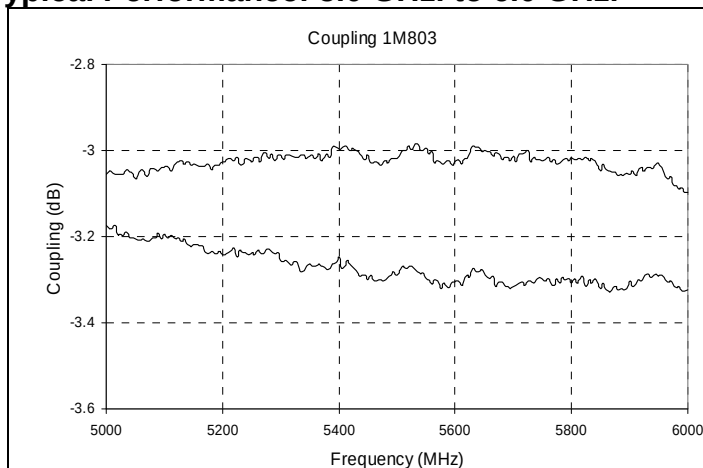
Frequency	Isolation	Insertion Loss	VSWR	
GHz	dB Min	dB Max	Max:1	
5.0 – 6.0	20	0.25	1.21	
4.8 – 6.0	20	0.25	1.21	
Amplitude Balance	Phase Balance	Power	ΘJC	Operating Temp.
dB Max	Degrees	Ave. CW Watts	°C/Watt	°C
± 0.30	± 3	20	78.1	-55 to +85
± 0.40	± 3.5			

**Specification based on performance of unit properly installed on microstrip printed circuit boards with 50 Ω nominal impedance. Specifications subject to change without notice.

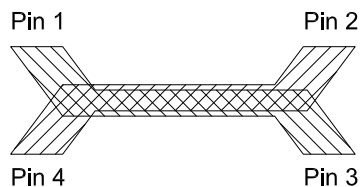
Mechanical Outline



Typical Performance: 5.0 GHz. to 6.0 GHz.



Pin Configuration

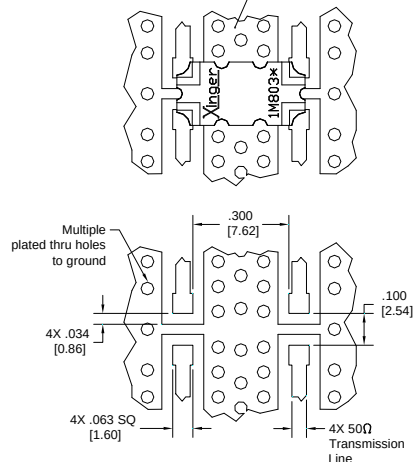


Hybrid Coupler Pin Configuration

	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
Configuration #1	Input	Isolated	-3dB, -90°	-3dB, 0°
Configuration #2	Isolated	Input	-3dB, 0°	-3dB, -90°
Configuration #3	-3dB, -90°	-3dB, 0°	Input	Isolated
Configuration #4	-3dB, 0°	-3dB, -90°	Isolated	Input

Mounting Footprint

To ensure proper electrical and thermal performance there must be a ground plane with 100% solder connection underneath the part



Dimensions are in Inches [Millimeters]
1M803* Mounting Footprint

USA/Canada: (315) 432-8909
Toll Free: (800) 544-2414
Europe: +44 2392-232392

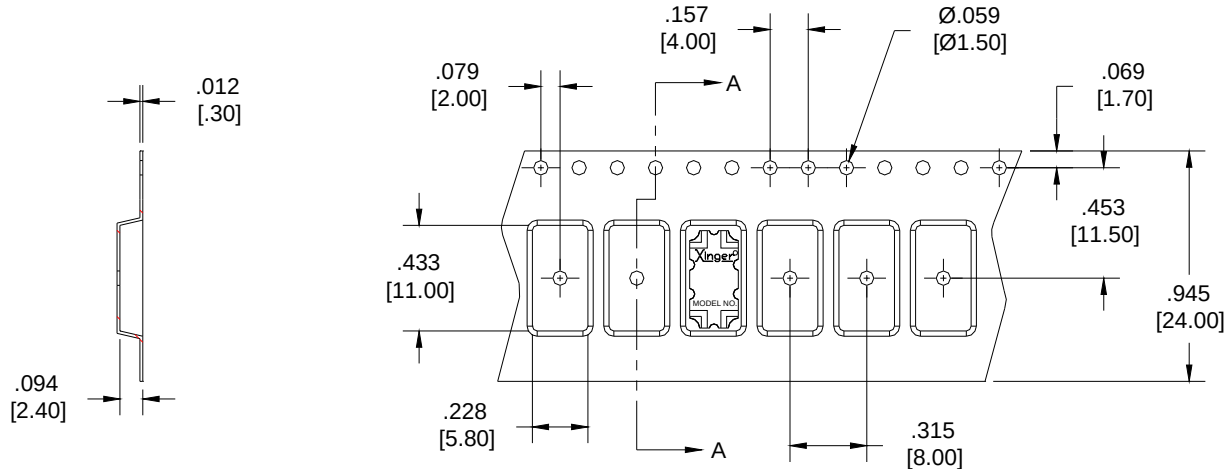
Available on Tape and
Reel For Pick and Place
Manufacturing.



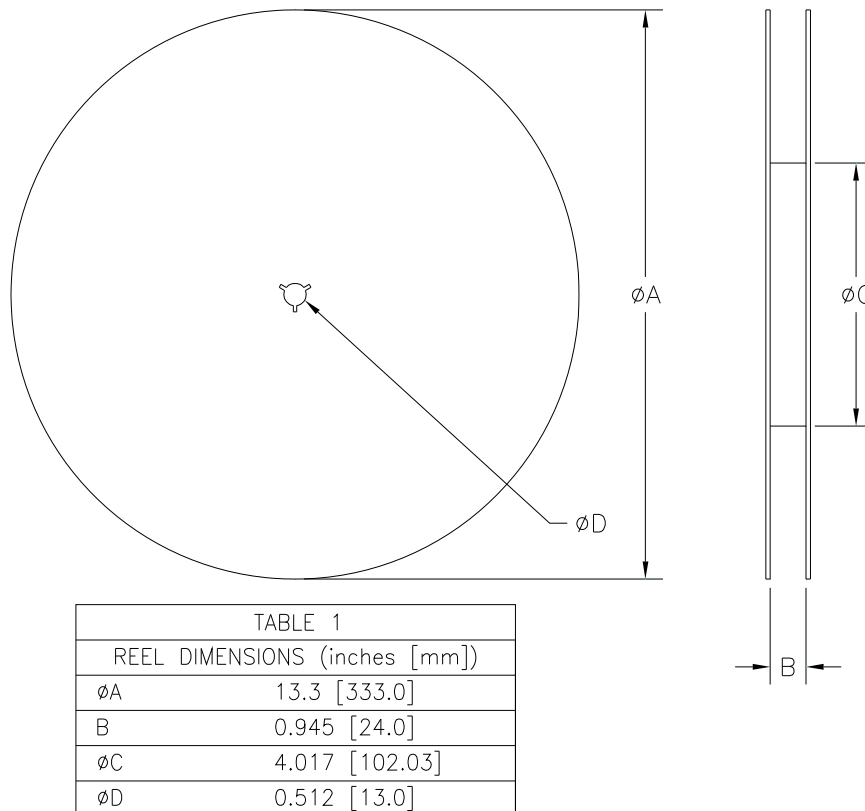
Anaren
What'll we think of next

PACKAGING

Packaging follows EIA-481-2. Parts available in tape and reel. Contact Customer service for Minimum reel order quantity.



Tape and Reel Diagram



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9